证券代码：300606　　证券简称：金太阳

东莞金太阳研磨股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、诺安基金、博时基金、国源信达资本、壹泽投资、粤大资产、旭辉资产、沐德资产、开源电子、浙商证券、国盛证券
时间	2026 年 10 月 28 日（星期三)
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	金太阳 副总经理兼董事会秘书 杜燕艳 领航电子 CEO 杨勋
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司介绍** 公司简介、经营业务及未来发展规划。 **二、问答环节主要内容** **1、公司 2026 年前三季度的经营业绩如何？** 答：公司 2026 年前三季度，公司累计实现营业收入 38,083.23 万元，归母净利润 1,802.64 万元，若剔除股权激励摊销金额影响，公司归母净利润同比实现约 5%的增长；毛利率为 26.71%，同比上升约 3 个百分点。 公司经营基本面保持稳健。在巩固研磨抛光材料业务稳定发展的同时，精密结构件业务正从 3C 消费电子领域逐步向液冷、机器人、光模块等高毛利的制造领域延伸，并依托集团技术协同优势，开发玻璃背板抛磨机床等高附加值产品线，持续为客户提供“抛光耗材+智能装备+工艺优化”一站式解决方案。 因主动推进精密结构件业务转型，公司营业收入短期有小幅

	下滑，但产品结构优化将为后续业绩的快速增长夯实基础。 **2、公司引进陈湛博士加入董事会的原因？** 答：公司邀请陈湛博士加入董事会，进一步深度绑定高端人才，为公司技术研发注入强劲动力。一方面，陈湛博士逾 20 年的半导体抛光液研发与产业化经验，将显著增强公司在半导体材料领域的研发实力，加速公司向半导体延伸布局；另一方面，其深厚的材料学功底与技术领导力，将带动公司整体研发体系升级与团队整体素质提升，加速公司研磨抛光材料新产品投放和现有产品技术迭代，全面提升公司产品竞争力。公司亦将依托博士工作站等创新研发平台，进一步集聚高端人才、深化产学研协同，为长期技术领先蓄势赋能。 **3、公司股权激励进展如何？是否授予完成？** 答：公司 2026 年推出的股权激励计划计划授予股数 430 万股，其中首次授予 370 万股，预留部分 60 万股，预留部分将用于持续引才、留才。截至目前，首次授予股数已经全部授予完毕，授予日为 2026 年 9 月 1 日。 **4、公司对领航电子增资的原因？** 答：公司秉承“聚焦科技创新，智领行业发展，铸就精密研磨抛光世界一流服务商”的企业愿景，自 2004 年成立以来长期从事精密研磨抛光材料的研发、生产和销售，持续深耕研磨抛光赛道并积极推进产业链延伸布局，以芯片抛光液为抓手切入半导体赛道，加速实现向高端半导体领域转型的平台型公司。 领航电子系公司于 2021 年 11 月与深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立，公司为其创始股东之一，本次增资前已持有其 28.49%的股权。本次增资系公司在既有参股基础上，进一步向半导体关键材料领域延伸的业务布局。主要战略考虑如下： 其一，公司在磨料制备、抛光配方开发及量产工艺方面具有较长期的技术积累，与领航电子所从事的 CMP 抛光液业务在底

层技术上具有一定共通性，有利于双方在研发方向、工艺开发等方面的协同，提升研磨材料的研发水平，加大力度拓展用于半导体领域的研磨类耗材，实现高端产品线市场份额快速提升。

其二，领航电子产品覆盖消费电子抛光、衬底抛光及 IC 抛光液三大产品线，应用于芯片制造（IC Fab）、半导体晶圆（Substrate）及消费电子（3C）结构件制造领域；目标客户为消费电子、晶圆制造、芯片制造、先进封装及衬底制造企业，与公司现有客户结构及供应链管理能力具有一定互补性。

其三，CMP 抛光液作为芯片制造中不可或缺的关键耗材，属于高壁垒、长周期的精细化学品领域；当前半导体产业链国产化浪潮势不可挡，半导体材料需求增长迅猛。公司希望通过此次增资，把握半导体关键材料领域的发展机遇。

5、在抛光液领域公司的竞争优势体现在什么方面？

答：领航电子已建成年产万吨级产能体系，目前正持续推进各产品线验证及量产导入工作，具备技术壁垒向规模化收入转化的产业化基础。领航电子始终以客户需求为导向，通过核心磨料自研+丰富的芯片抛光液产业化经验打造核心竞争力。其中钨抛光液作为公司的核心支柱产品，已取得阶段性里程碑。公司核心技术团队实力突出，核心成员陈湛博士为佛罗里达大学材料科学与工程专业博士，历任英特尔高级制程工程师，嘉柏微电子资深研究员、产品线总监及企业发展总监，安集微电子(上海)有限公司副总经理，具备芯片抛光液直接研发与产业化经验；杨勋博士为加州大学洛杉矶分校化学专业博士，曾任华为技术有限公司主任工程师。此外，相比国外同类产品，公司更具成本优势，能够精准契合FAB厂对供应链优化与降本增效的核心诉求。

6、领航电子半导体抛光液进展怎么样？

答：领航电子核心产品钨抛光液已经获得国内头部 FAB 厂订单，标志着公司半导体抛光液正式进入国内主流晶圆制造供应链，成为公司半导体产业布局中极具标志性的里程碑事件。

	风险提示：领航电子核心产品钨抛光液获得的国内头部 FAB 厂订单金额较小，对公司经营业绩不构成重大影响，相关订单后续交付与放量节奏、国产化替代进程受客户验证周期及行业景气度等因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026-10-28